



*Smart Solutions & Services  
for Your Manufacturing*

**2022年3月期**

# **決算説明**

**2022年5月12日**

**芝浦メカトロニクス株式会社**

# 目次

- 1. 2022年3月期 決算概要**
- 2. 2023年3月期 業績予想**
- 3. 中期経営計画の進捗**

## 業績結果 (対前年)

増収増益、ROS10.3%

【連結】

単位：億円

	2020 年度	21/上	21/下	2021 年度	対前年 増減率
売上高	448	219	274	493	+10%
営業利益	29.6	18.5	32.0	50.5	+71%
R O S	6.6%	8.4%	11.9%	10.3%	+3.7pt
経常利益	28.2	17.5	31.3	48.8	+73%
特別損失	-	6.1	-	6.1	-
当期純利益	19.7	7.5	22.3	29.8	+52%
R O E	9.5%	-	-	12.8%	+3.3pt
受注高	420	293	415	709	+69%
F C F	74.1	-	-	77.9	+3.8

## 業績結果まとめ (対前年) ①

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
FPD : FPD前・後工程装置

- 売上高 前年比10%増収 (448億円 ⇒ 493億円)
  - SPE分野は増加し、FPD分野が減少したが、全体として増収
- 営業利益 前年比71%増益 (29.6億円 ⇒ 50.5億円)
  - SPE分野の売上増加と利益率の改善により、営業利益は増益
- 当期純利益 前年比52%増益 (19.7億円 ⇒ 29.8億円)
  - 第1四半期連結累計期間で横浜事業所再開発に伴う特別損失 (6.1億円) を計上したが、当期純利益は増益
- 受注高 前年比69%増加 (420億円 ⇒ 709億円)
  - SPE分野が好調に推移し、FPD分野も堅調に推移

## 業績結果まとめ（対前年）②

### ■ ファインメカトロニクス部門

\* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

#### ➤ 売上高 前年比6%増 (296億円 ⇒ 314億円)

半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやパワーデバイス向け、ウェーハ向けが堅調で増加。

FPD前工程では、前年度受注低調の影響などにより減少。

#### ➤ セグメント利益 前年比49%増 (19.9億円 ⇒ 29.8億円)

半導体前工程は売上増加で増益で、FPD前工程が売上減少などで減益だが、全体として増益。

#### ➤ 受注高 前年比64%増 (292億円 ⇒ 479億円)

半導体前工程では、ウェーハ向けやパワーデバイス向けを中心に好調に推移。

FPD前工程では、大型パネル向け、中小型パネル向けとも低水準で推移。

ヘルスケア分野のインクジェット錠剤印刷装置は、まとまった受注を獲得。

## 業績結果まとめ (対前年) ③

## ■ メカトロニクスシステム部門

\*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- 売上高 前年比22%増 (113億円 ⇒ 138億円)  
半導体後工程では、2.5Dなど先端パッケージ向けやFO-PLP向け、ディスプレイドライバIC向けが全体として好調で増加。  
FPD後工程では、大型パネル向け、中小型パネル向けとも堅調であったものの、一部顧客の投資計画後ろ倒しの影響により減少。
- セグメント利益 前年比158%増 (7.9億円 ⇒ 20.4億円)  
半導体後工程の売上増加などにより増益。
- 受注高 前年比103%増 (91億円 ⇒ 185億円)  
半導体後工程では、先端パッケージ向けやFO-PLP向けを中心に好調に推移。  
FPD後工程では、大型パネル向けが順調に推移し、中型パネル向けでは車載用途での受注獲得。

## 業績結果 (対前回予想)

\*1: 2021年11月公表  
単位：億円

【連結】

	2021年度		
	前回予想 *1	実績	対前回予想 増減率
売上高	480	493	+3%
営業利益	42.5	50.5	+19%
R O S	8.9%	10.3%	+1.4pt
経常利益	40.5	48.8	+20%
特別損失	6.1	6.1	-
当期純利益	25.0	29.8	+19%
R O E	11.0%	12.8%	+1.8pt
受注高	-	709	-

## 業績結果まとめ (対前回予想)

- 売上高                      前回予想比3%増収 (480億円 ⇒ 493億円)
  - SPE分野が増加し、FPD分野は前回予想通りで、全体として増収
- 営業利益                      前回予想比19%増益 (42.5億円 ⇒ 50.5億円)
  - SPE分野の売上増加と利益率改善、経費抑制により改善
- 当期純利益                      前回予想比19%増益 (25.0億円 ⇒ 29.8億円)
  - 営業利益改善による



## 配当

2022年3月期の期末配当は、当期純利益が前回予想を上回ったため、30円引き上げ230円を予定しています。

当社は、連結配当性向25%～30%を目途としており、今回予定している2022年3月期期末配当には、第1四半期連結累計期間において計上した特別損失反映前の連結配当性向を加味しております。

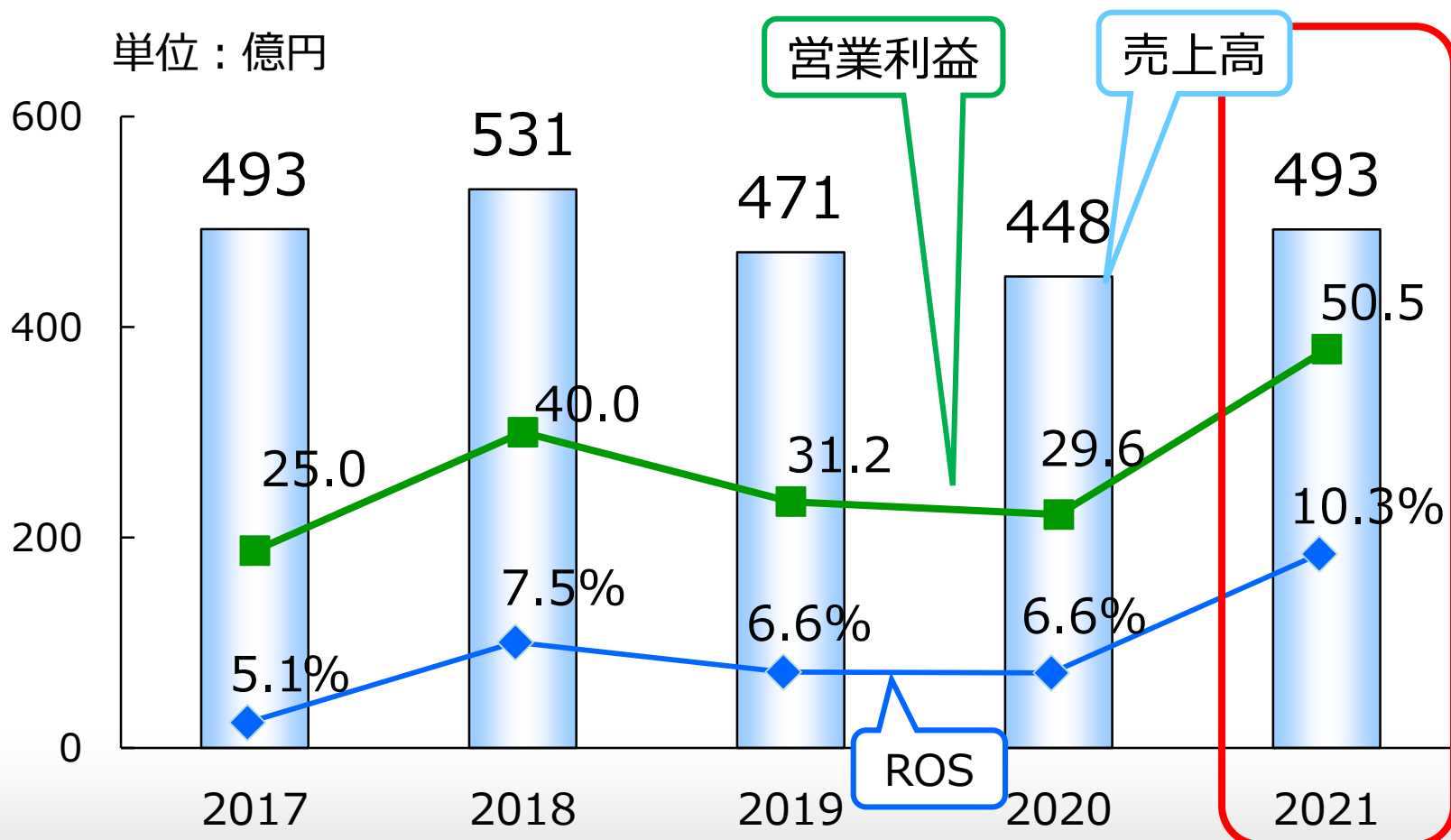
	第2四半期 末配当	期末配当	年間配当
2022年3月期	0円	230円	230円
2022年3月期（前回予想）	0円	200円	200円
2021年3月期	0円	110円	110円

## 売上高・利益・ROS

SPE分野が増加しROS10.3%

【連結】

単位：億円



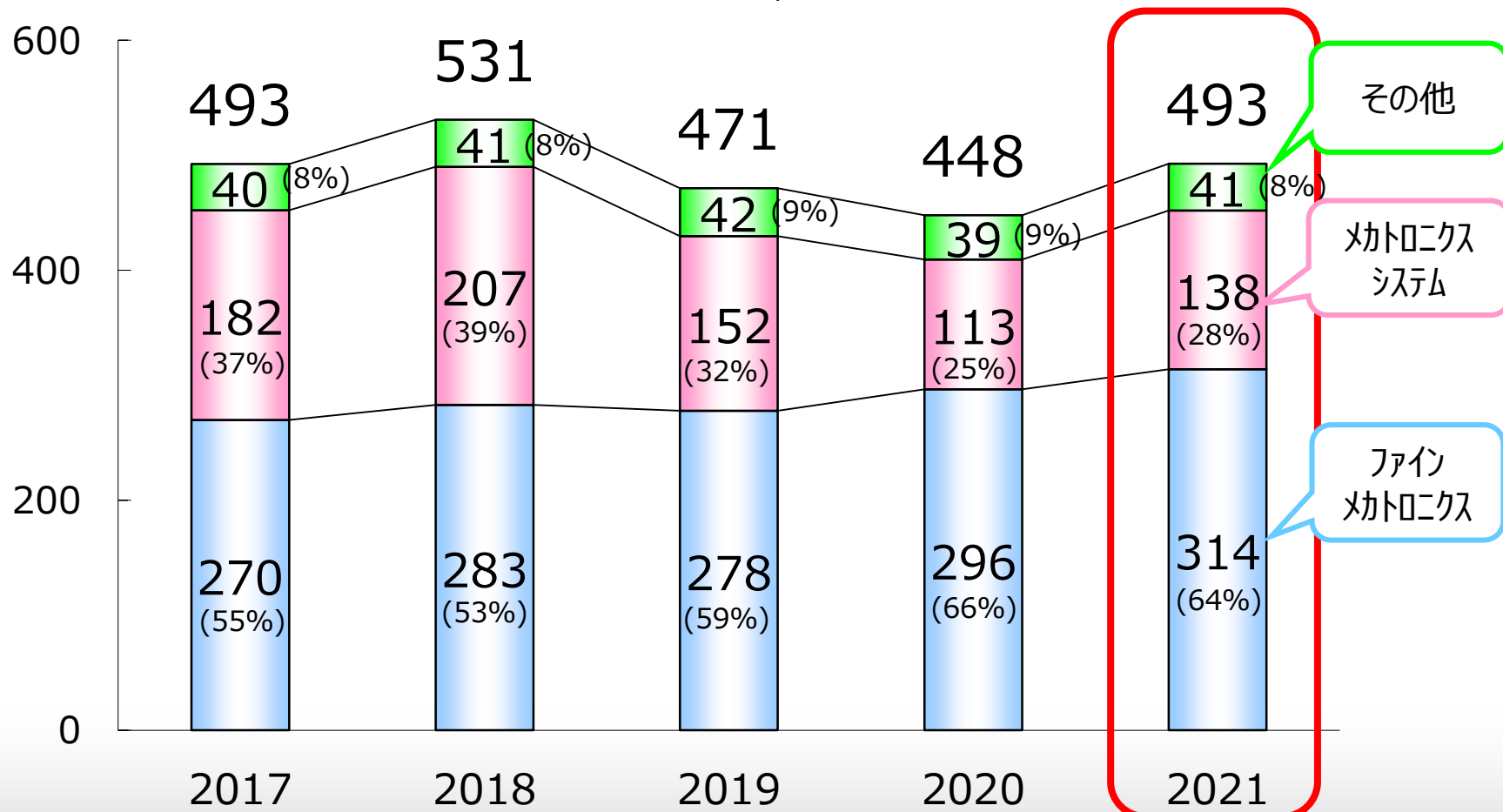
## セグメント別売上高

ファインメカトロニクスが64%

【連結】 単位：億円

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

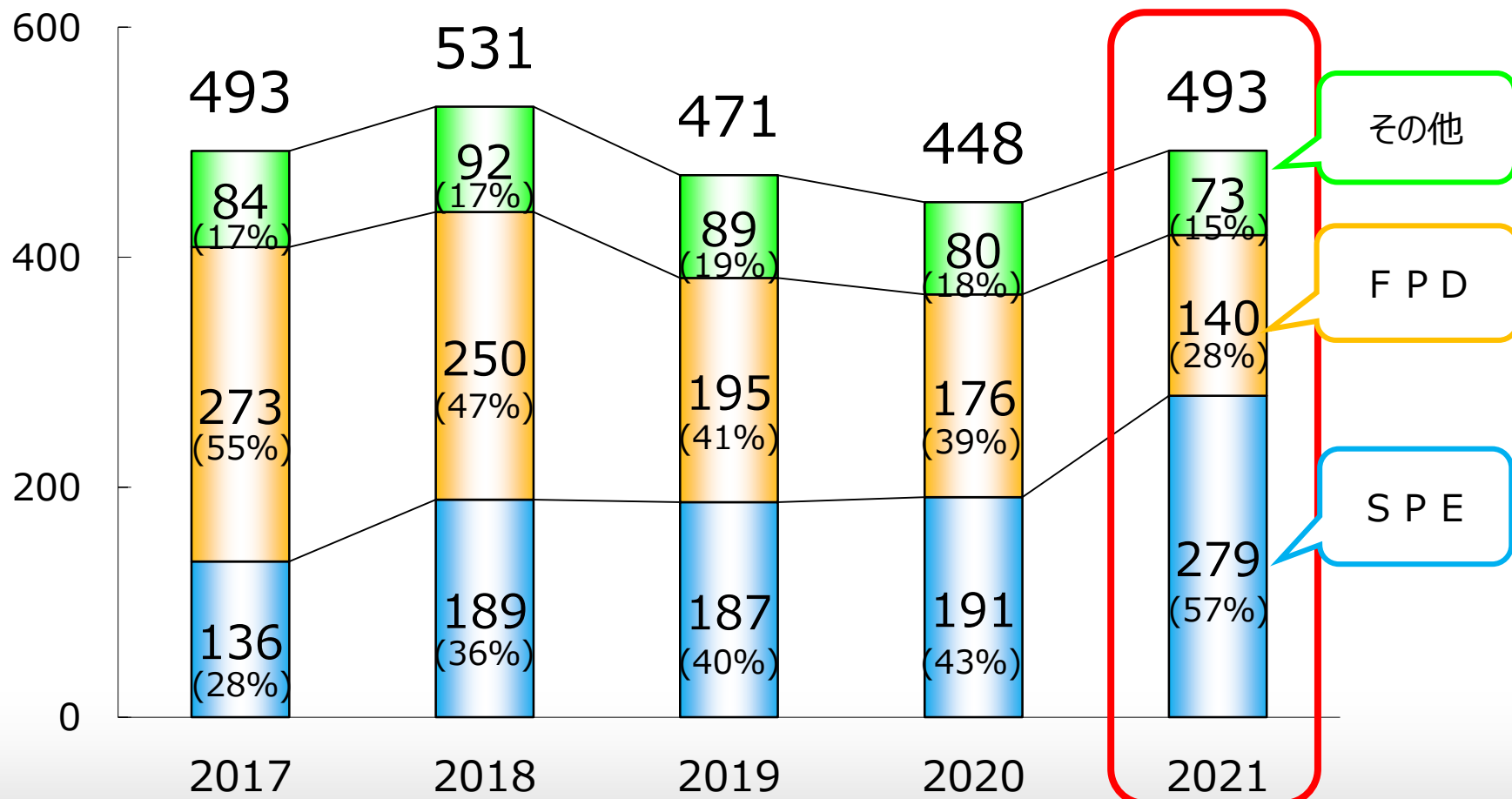


## 分野別売上高

SPE分野が大幅に増加し57%

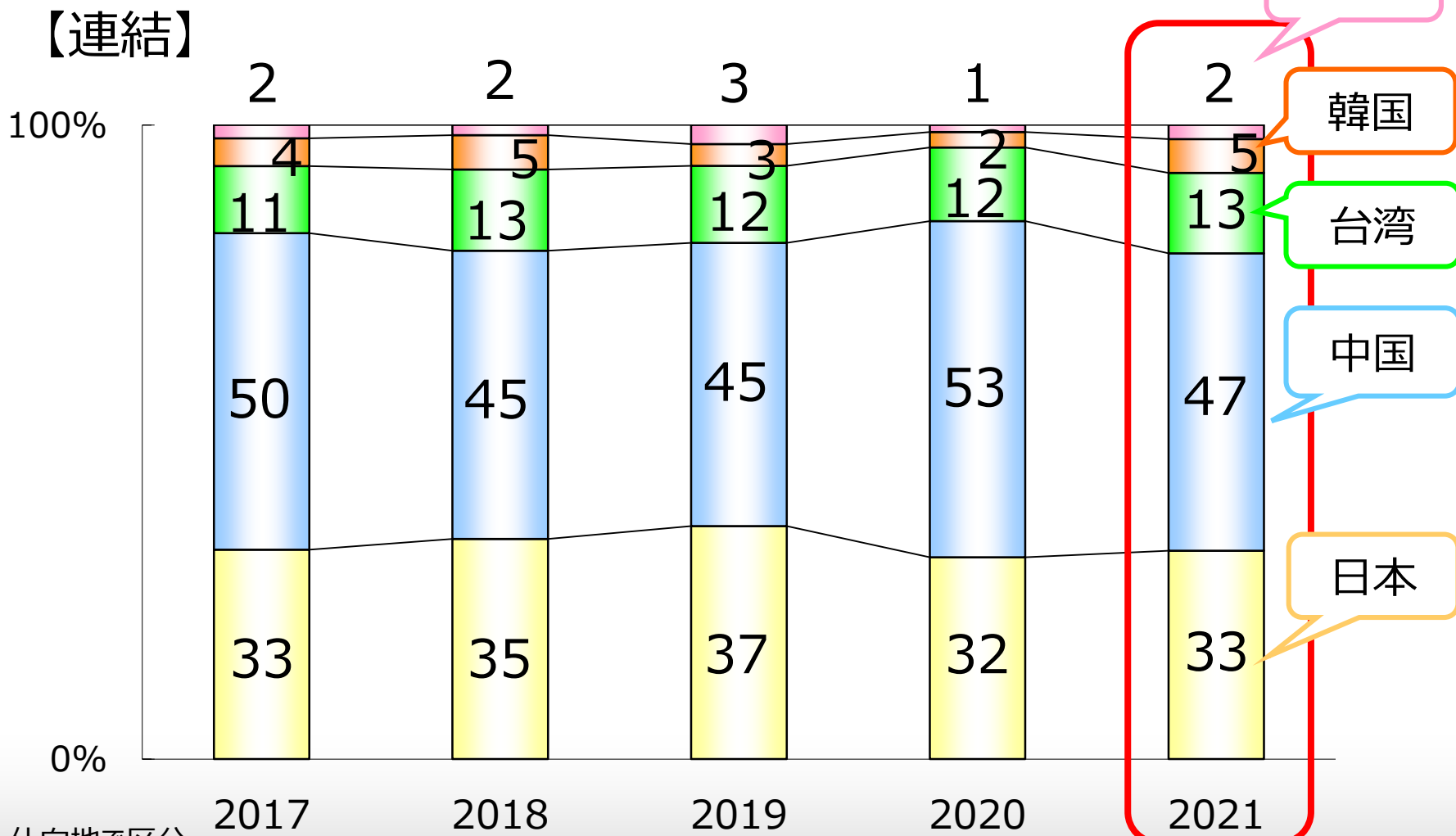
【連結】 単位：億円

\* SPE : 半導体前・後工程装置  
FPD : FPD前・後工程装置



## 地域別売上高比率

海外向け67% (中国47%)



\* 仕向地で区分

## セグメント別受注高

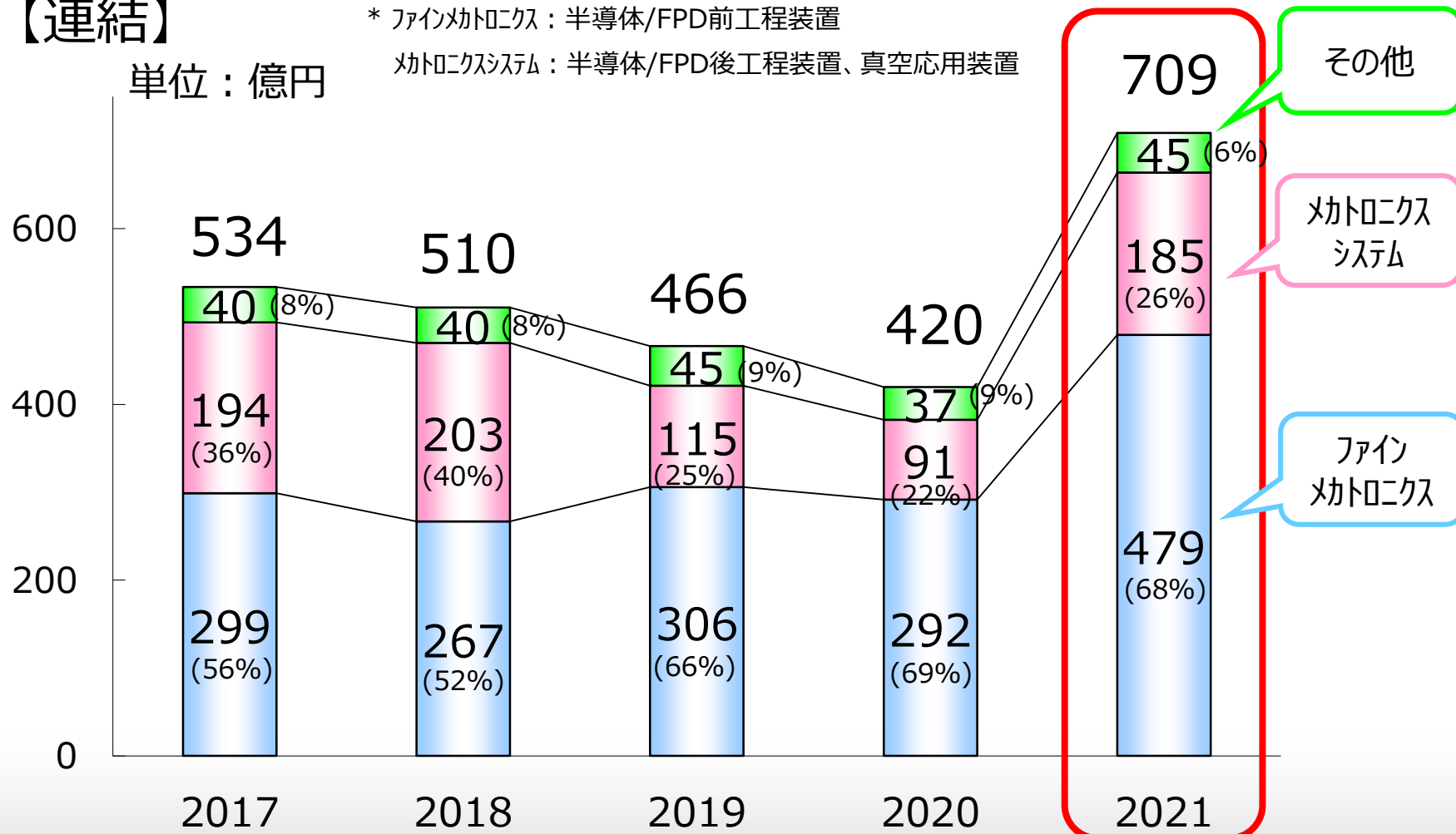
ファインメカトロニクス、メカトロニクスシステム  
ともに大幅増で、受注好調

【連結】

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

単位：億円

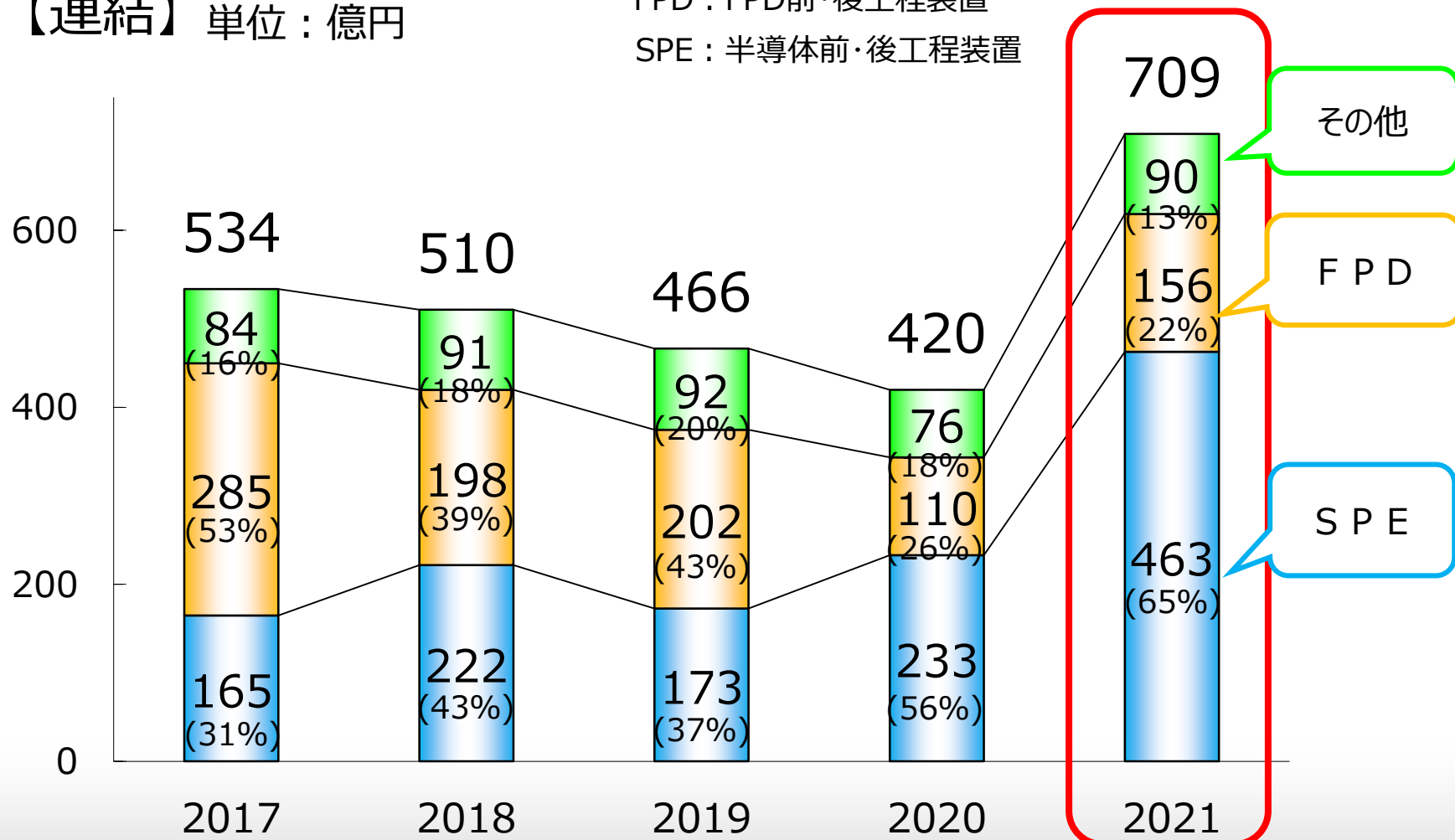


## 分野別受注高

SPE分野が大幅に増加し65%

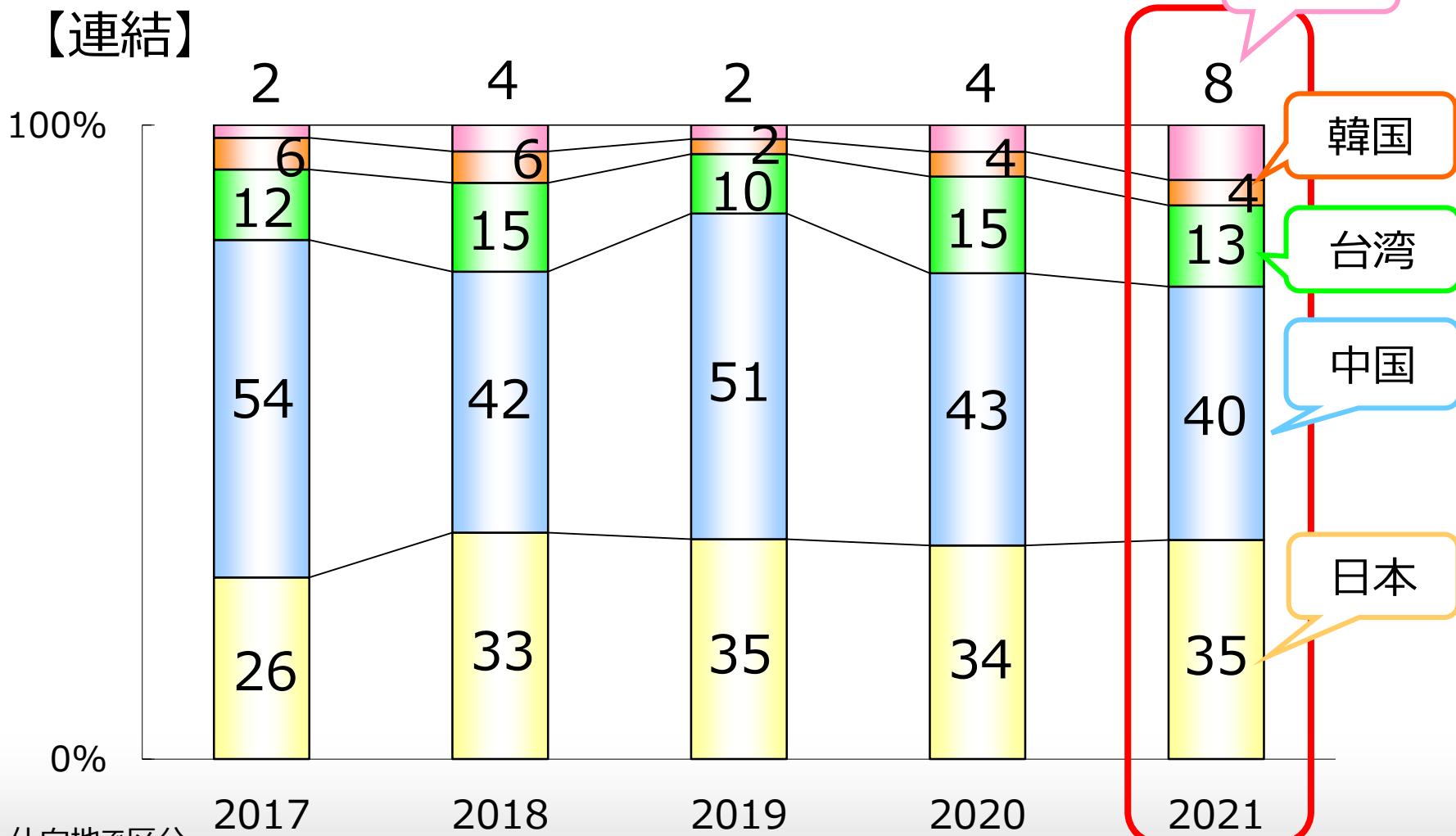
【連結】 単位：億円

\* FPD：FPD前・後工程装置  
SPE：半導体前・後工程装置



## 地域別受注高比率

海外向け65% (中国40%)



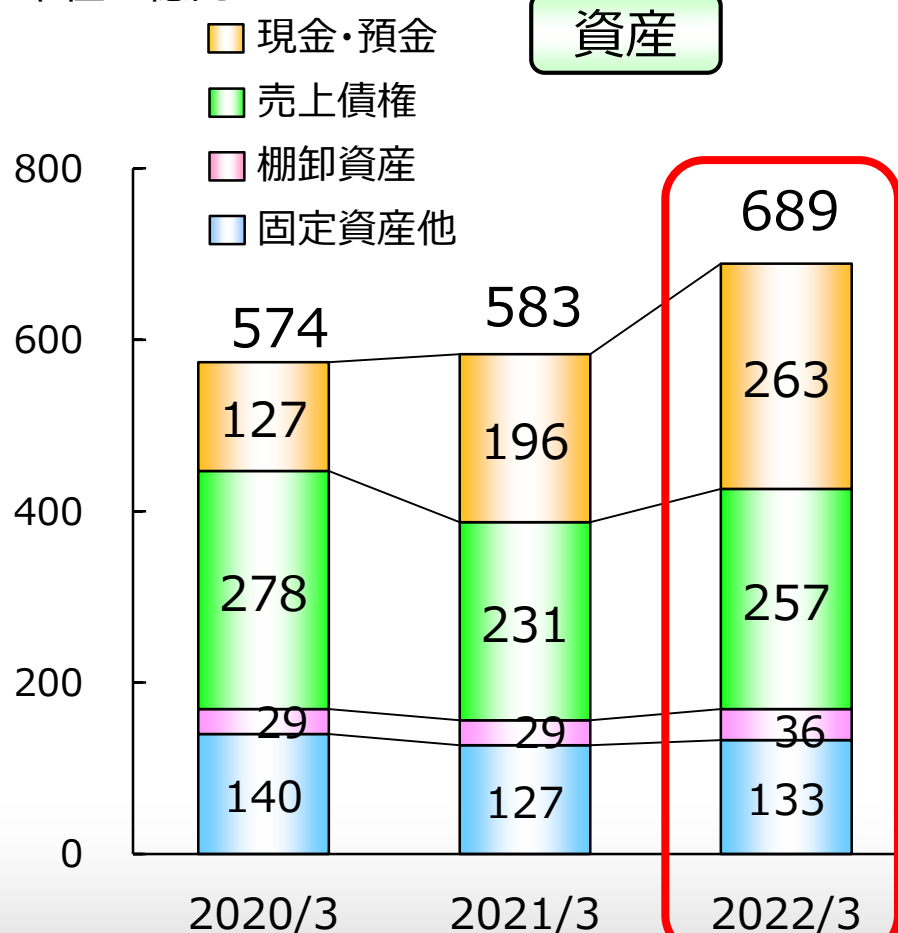
\* 仕向地で区分



## 貸借対照表

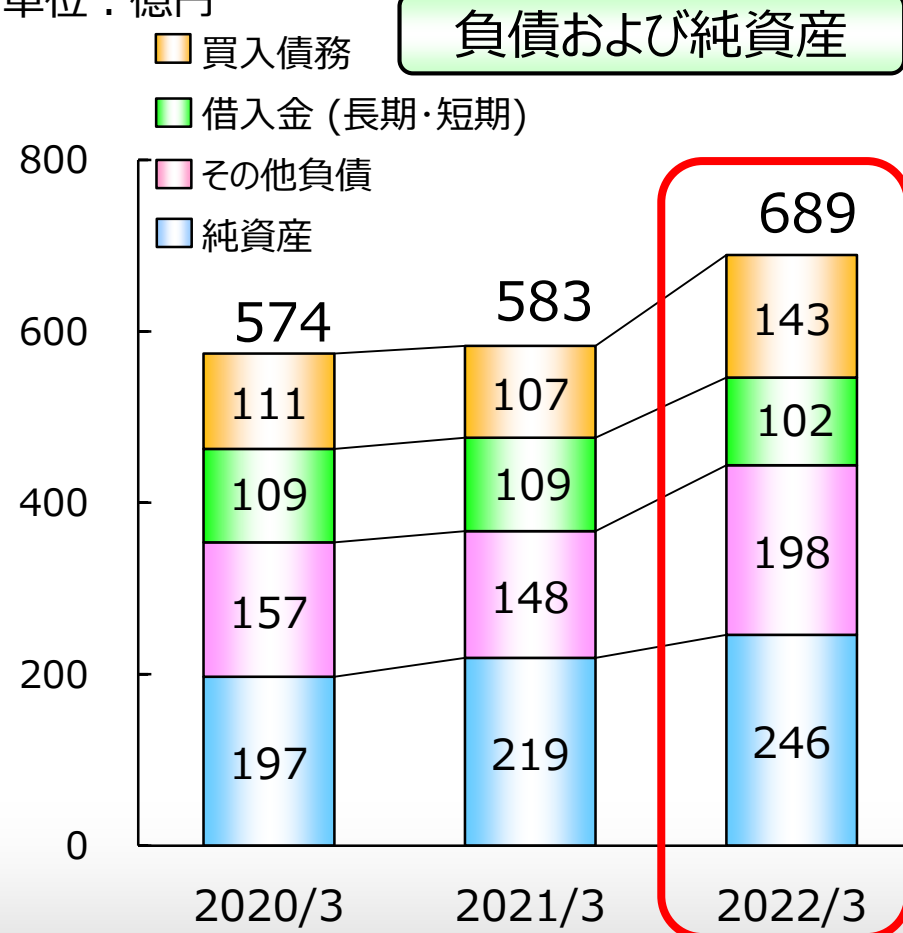
【連結】

単位：億円



自己資本比率 37% ('21/3) → 36% ('22/3)  
 D/Eレシオ 50% ('21/3) → 41% ('22/3)  
 ROE 9.5% ('21/3) → 12.8% ('22/3)

単位：億円



# 目次

1. 2022年3月期 決算概要
- 2. 2023年3月期 業績予想**
3. 中期経営計画の進捗

## 業績予想

増収増益、ROS12%

\*22/上、22/下見通しはご参考

【連結】

単位：億円

			2021 年度			2022 年度 予想	対前年 増減率
	21/上	21/下		22/上 見通し	22/下 見通し		
売上高	219	274	493	270	290	560	+14%
営業利益	18.5	32.0	50.5	29.5	37.5	67.0	+33%
R O S	8.4%	11.7%	10.3%	10.9%	12.9%	12.0%	+1.7pt
経常利益	17.5	31.3	48.8	28.0	37.0	65.0	+33%
特別損失	6.1	-	6.1	-	-	-	-
当期純利益	7.5	22.3	29.8	23.5	27.5	51.0	+71%
R O E	-	-	12.8%	-	-	19.1%	+6.3pt
配当	-	-	230円	-	-	350円	120円
F C F	-	-	77.9	-	-	15.0	▲62.9

## 配当予想

当社は、2023年3月期から、連結配当性向をおおむね30%を目途とします。

2023年3月期の期末配当は、350円を予定しています。

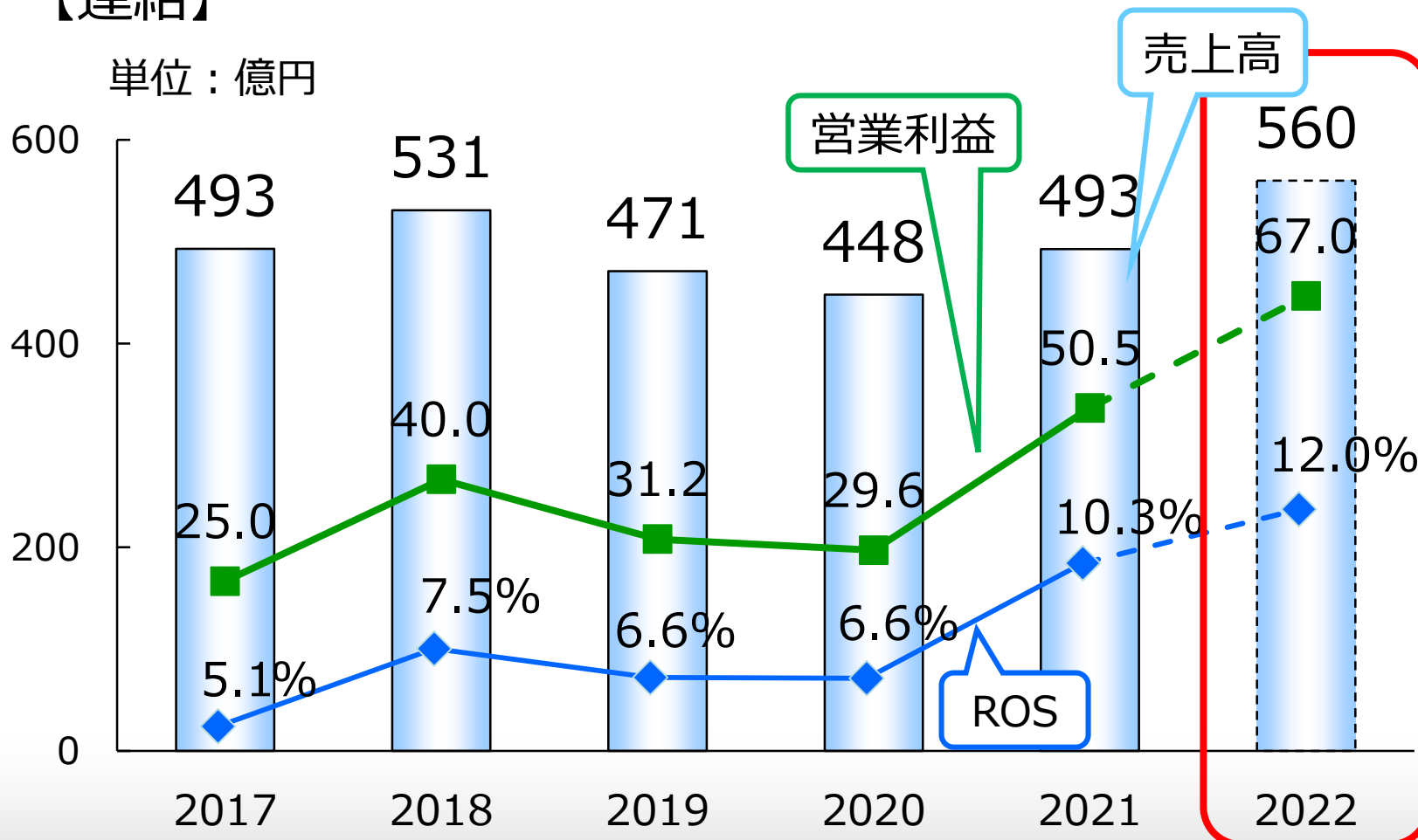
	第2四半期 未配当	期末配当	年間配当
2023年3月期	0円	350円	350円
2022年3月期	0円	230円	230円

## 売上高・利益・ROS

增收增益

【連結】

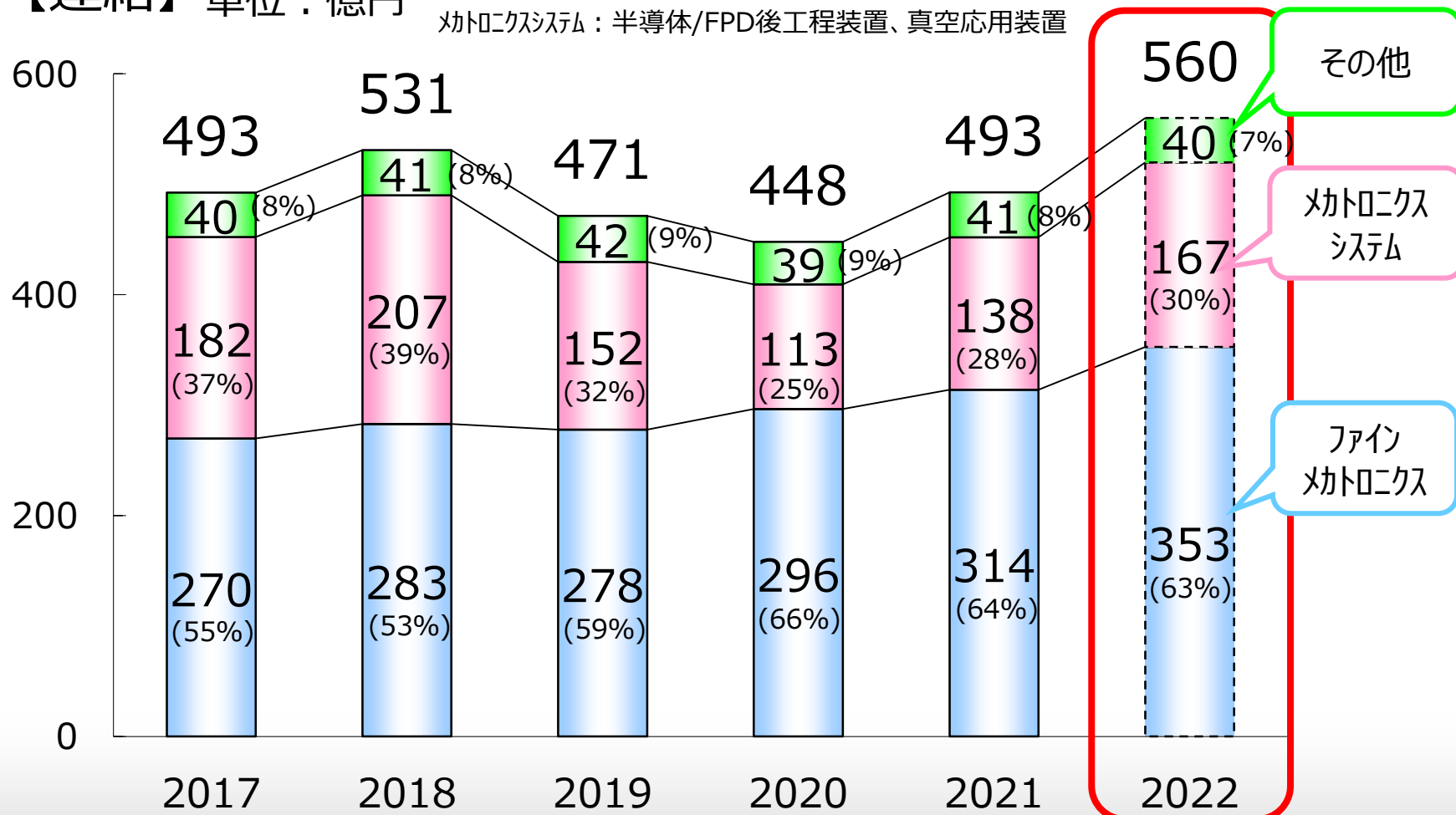
単位：億円



## セグメント別売上高

ファインメカトロニクスが63%

【連結】 単位：億円 \* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置  
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

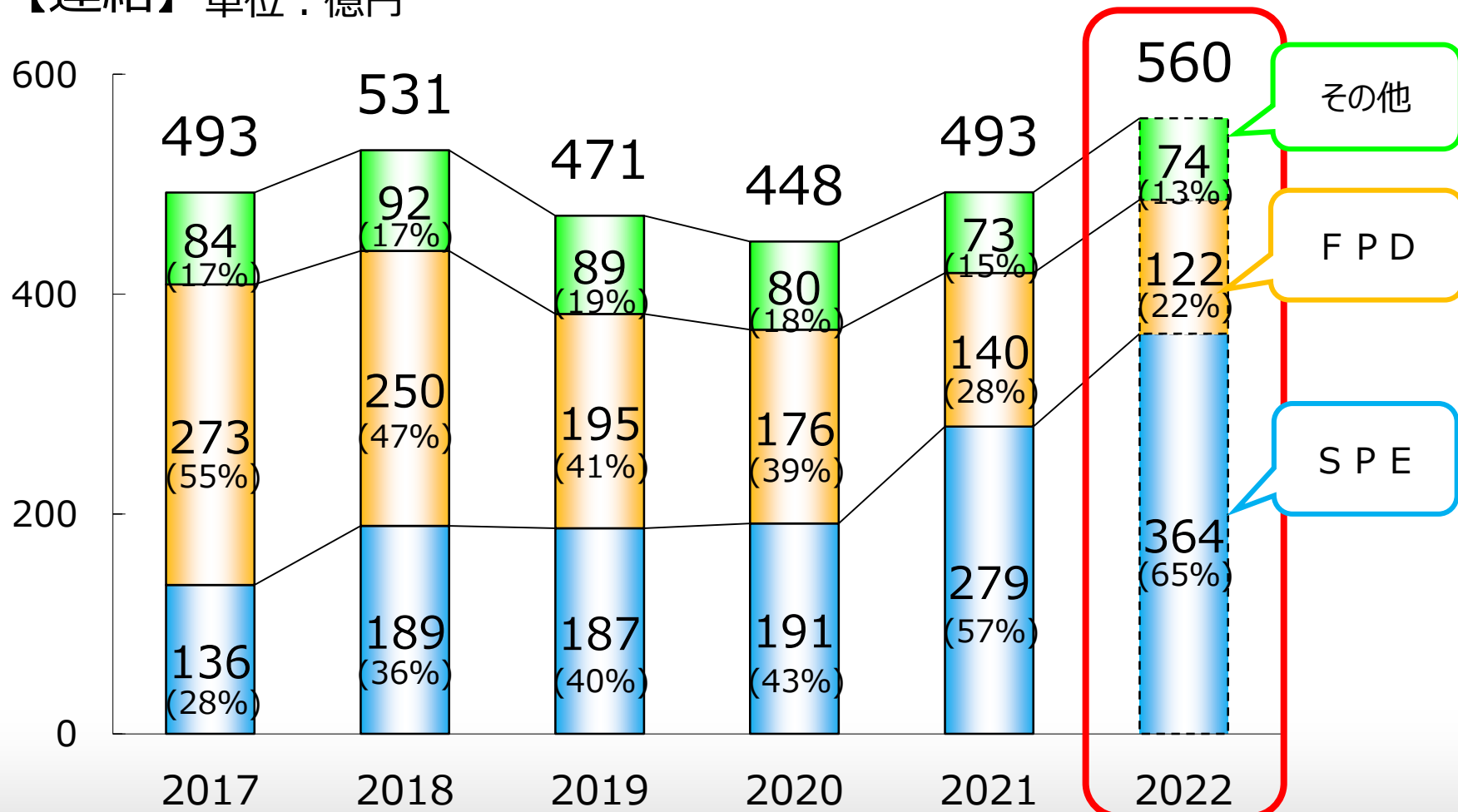


## 分野別売上高

SPE分野が65%

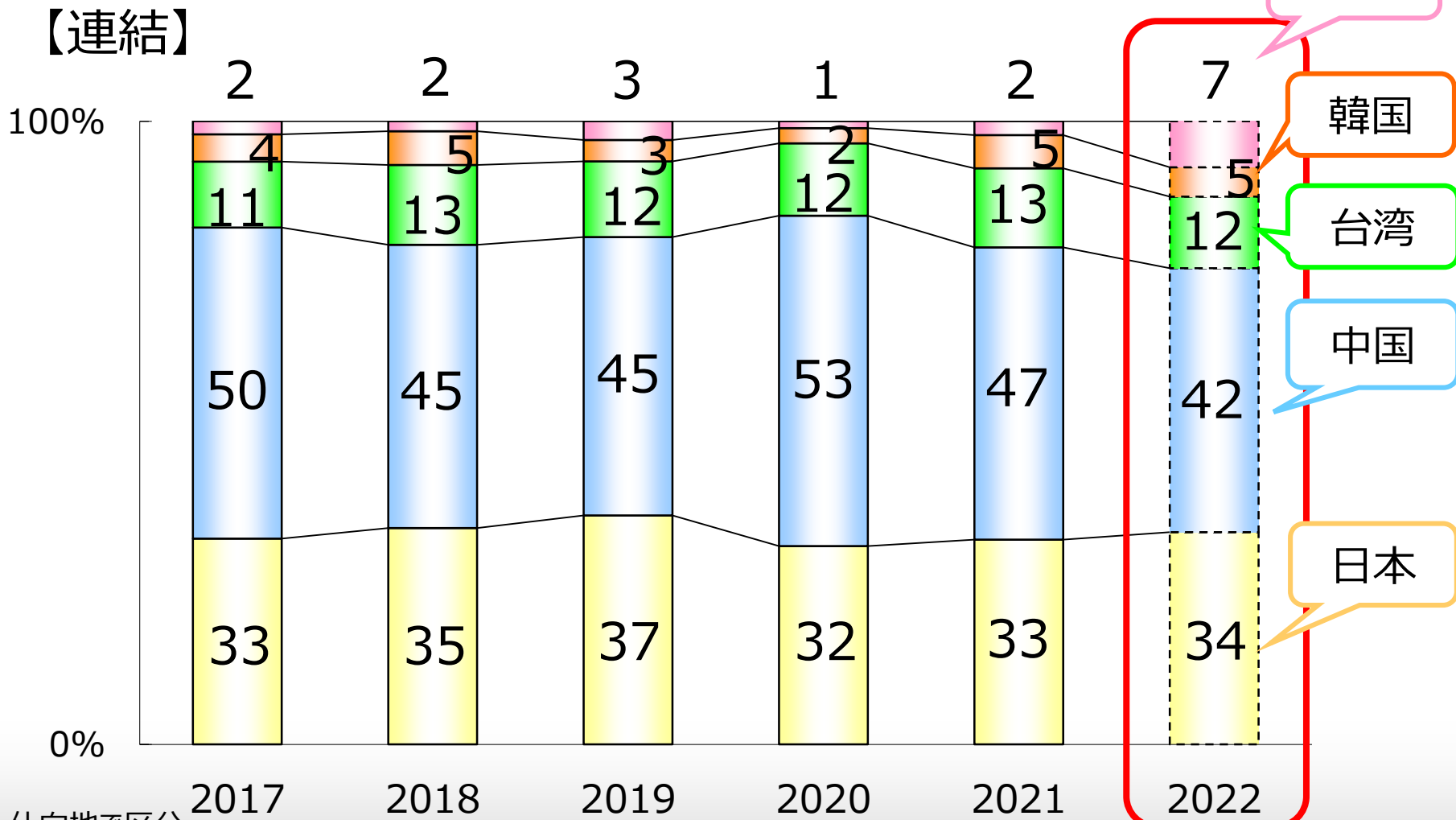
\* SPE : 半導体前・後工程装置  
FPD : FPD前・後工程装置

【連結】 単位：億円



## 地域別売上高比率

海外向け66% (中国42%)

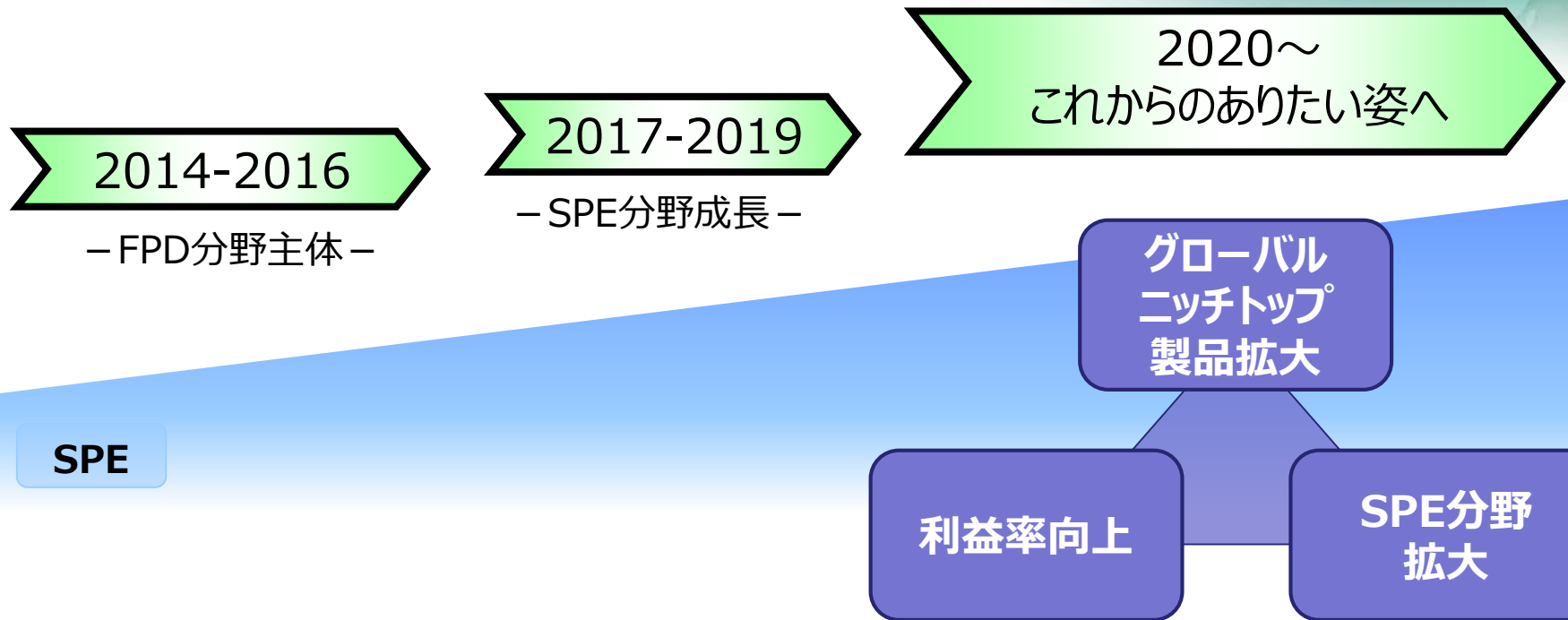


\* 仕向地で区分



# 目次

1. 2022年3月期 決算概要
2. 2023年3月期 業績予想
- 3. 中期経営計画の進捗**



FPD

**これからのありたい姿**

- ◆ IoT、5G、AIと、これから更に広がるデータ社会に向けて、半導体・FPD製造装置を通じた先端技術で貢献 ～「ものづくり」から「価値づくり」～
- ◆ SPE分野でグローバルニッチトップ、FPD分野で主要サプライヤとして存在感を示せる企業グループへと成長

## 中期経営計画の進捗

2022年度は中計目標の  
売上・利益を上回る

\*1: 2020年11月公表

単位：億円

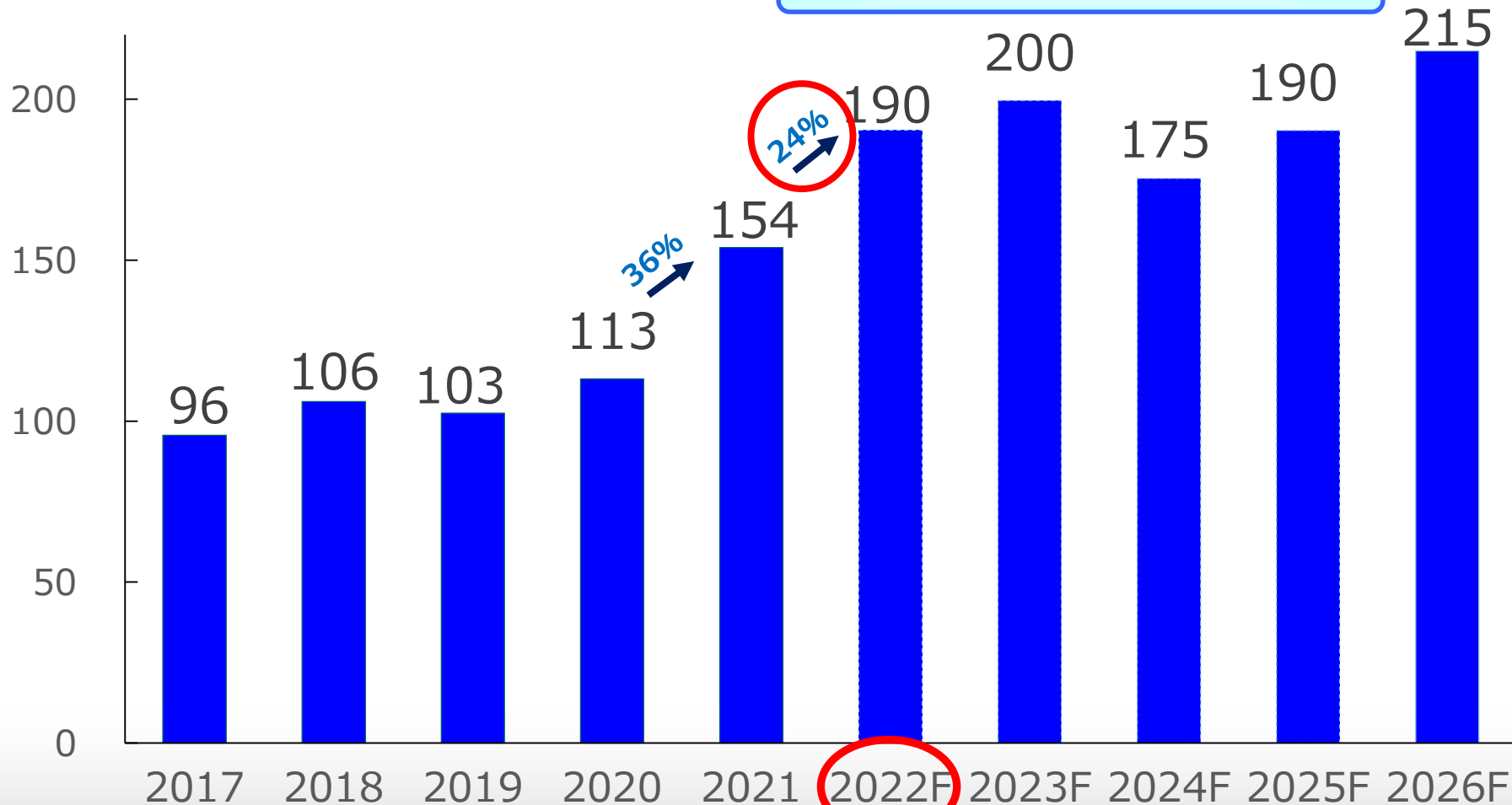
	2020	2021	2022	中期経営計画年度目標 *1		
	年度実績	年度実績	年度予想	2020	2021	2022
売上高	448	493	560	460	480	510
営業利益	29.6	50.5	67.0	30.0	38.5	51.0
R O S	6.6%	10.3%	12.0%	6.5%	8.0%	10.0%
経常利益	28.2	48.8	65.0	-	-	-
当期純利益	19.7	29.8	51.0	-	-	-
R O E	9.5%	12.8%	19.1%	9.5%	11.5%	13.0%

## 半導体工場・設備 投資高予測

\* 出典：IC Insights 2022-2  
当社にてグラフ作成

単位：10億US \$

2019-2022CAGR：22.9%



## 当社の事業環境

- IoT、5G、AIの発展で設備投資の拡大が期待される

現在の当社の事業環境は、受注面からみると

- ✓ SPE前工程 ロジック、Siウェーハ、パワーデバイス、  
いずれも投資継続、拡大
- ✓ SPE後工程 高精度Fan-Out, 2.5Dなど先端  
パッケージ向け投資が好調  
新技術ハイブリッド接合の引合い増加

## 当中期経営計画グローバル ニッチトップ対象製品群

工程	対象装置	主な対象製品等
Siウェーハ製造	枚葉式洗浄装置	300mmウェーハ (プライム、再生)
フォトマスク製造	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エッチング装置</li> <li>・枚葉式洗浄装置</li> </ul>	EUV用 blanks・マスク PSM用 blanks・マスク
ウェーハプロセス	枚葉式リン酸エッチング装置	ロジック/ファウンドリ
モジュールプロセス	高精度フリップチップボンダ	FO-WLP/PLP、2.5D、 CoWフュージョンボンディング

トピックス1

トピックス1

トピックス2

## Siウェーハ製造／ウェーハプロセス事例

GNT

当中期経営計画  
グローバル ニッチトップ  
対象製品群

GNT



枚葉式Siウェーハ洗浄装置  
(SC300 Series)

## &lt;特長&gt;

- ・枚葉式による高洗浄度対応
- ・マルチチャンバ化による高生産性対応
- ・CMP装置との豊富なインライン接続実績

## &lt;展開&gt;

- ・枚葉式洗浄で世界シェア No.1
- ・大手メーカーや新興国向け採用増で、引続き受注好調

GNT



枚葉式リン酸エッチング装置  
(SC300-HT Series)

## &lt;特長&gt;

- ・エッチングレートの精密制御、低パーティクル
- ・次世代乾燥技術
- ・3 nm以降の次世代プロセス対応

## &lt;展開&gt;

- ・大手ファウンドリでの実績をベースに受注拡大
- ・リン酸エッチングのアプリケーション拡大

## モジュールプロセス – 高精度フリップチップボンダ事例

GNT

先端パッケージボンダ  
(TFC-6500)

## &lt;特長&gt;

- ・2.5Dパッケージ用途はじめ、マイクロバンプの接合に適用
- ・ $\pm 1\mu\text{m}$ の高精度を実現
- ・清浄度：クラス100相当

## &lt;展開&gt;

- ・大手ファウンドリ、デバイスメーカー、OSATより継続受注
- ・車載関連、シリコンフォトニクス分野など用途拡大

GNT

フュージョンボンダ  
(TFC-6700)

## &lt;特長&gt;

- ・CoWチップレットに対応するフュージョンボンダ
- ・ $\pm 0.2\mu\text{m}$ の超高精度を実現
- ・清浄度：クラス1相当

## &lt;展開&gt;

- ・ロジック半導体、CISなど多分野へ展開中
- ・複数顧客への出荷実績
- ・量産化市場展開を見定めた製品開発を継続



## グローバルニッチトップ製品を核としたSPEの拡大

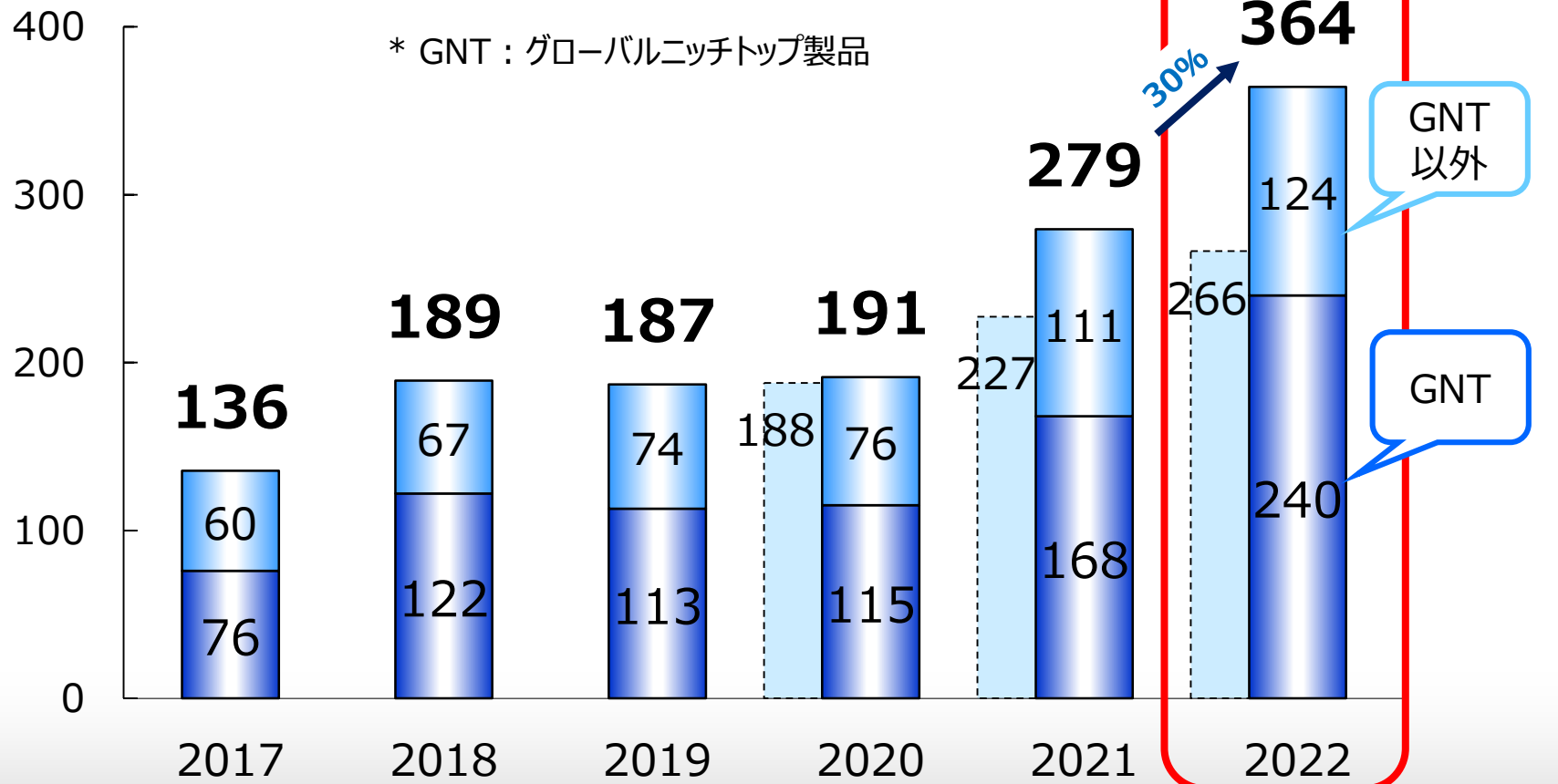
【連結】

単位：億円

■ '20-'22中期経営計画  
(2020/11/5公表)

■ '17-'21実績、'22予想

\* GNT：グローバルニッチトップ製品

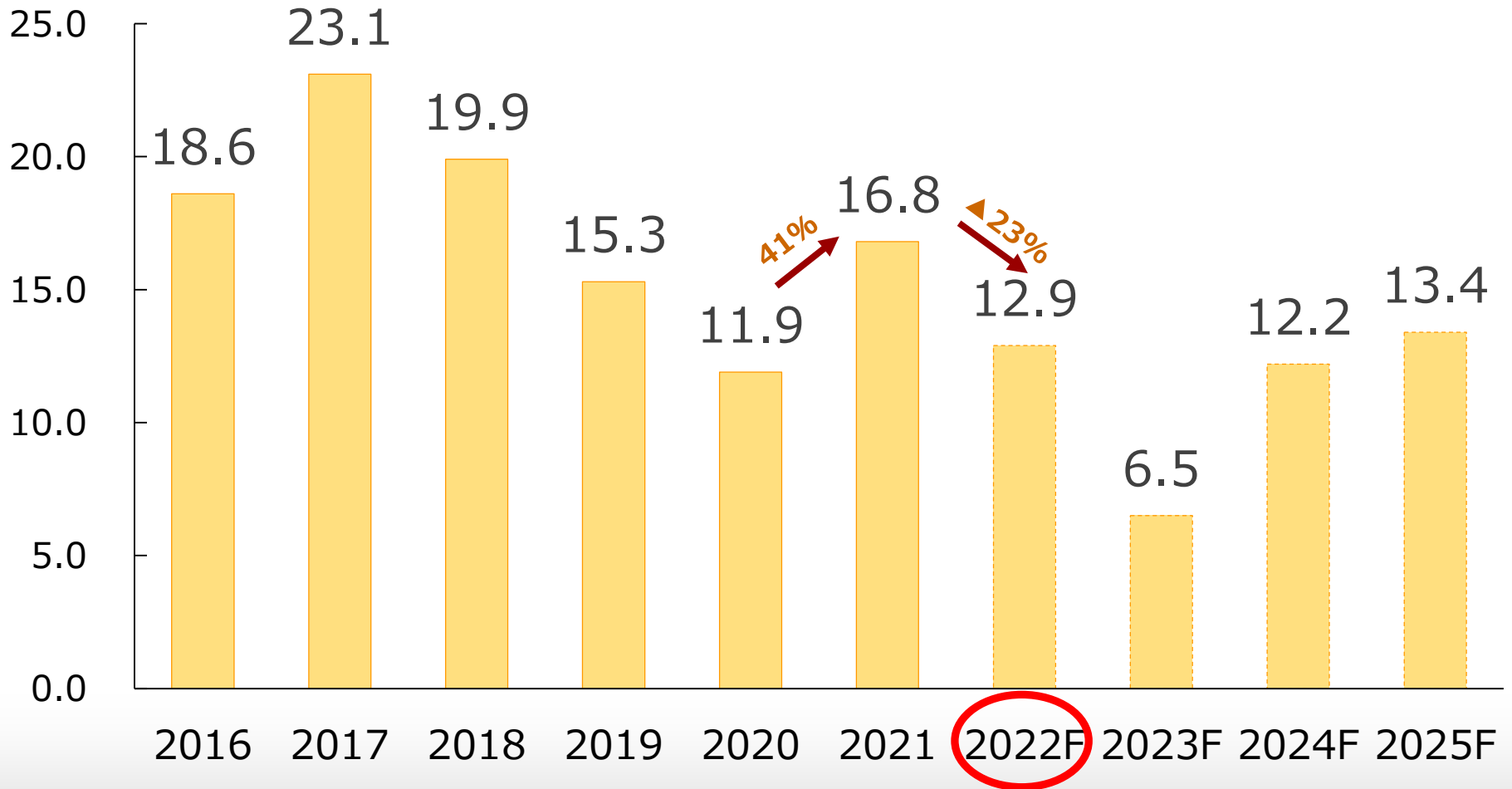


## 設備投資高予測

\* 出典：DSCC 2022-5  
当社にてグラフ作成

2019 - 2022 CAGR : ▲5.5%

単位：10億US \$



## 当社の事業環境

同様に受注面からみると

- ✓ FPD前工程    LCDはTV、ITパネルの需要増により  
新規&増設投資計画が具体化  
中小型OLEDは投資時期が流動的
- ✓ FPD後工程    大型、中小型とも投資は継続される  
見込み、中小型は特に車載、モニタ等の  
投資が堅調

## FPD新規製品事例



中型OLB  
(TTO-H3000M)

### <特長>

- ・幅広い適用パネルサイズと高精度技術の融合で多様な市場ニーズに対応
- ・高い生産性と安定稼働

### <展開>

- ・大手パネルメーカーからの受注継続
- ・大型化が進むモニタ、車載市場でのシェア拡大を図る

## ヘルスケア製品事例



インクジェット錠剤印刷装置  
(TIE-9000P/TIE-4500P)

### <特長>

- ・当社コア技術(IJ)を応用
- ・高速、高精細印字
- ・錠剤外観検査機能のオプション対応が可能
- ・インクの自社開発、製造販売

### <展開>

- ・複数の製薬メーカーに納入、量産稼働中
- ・業界初の3D形状検査機能などにより、国内シェア拡大と海外市場への拡販を図る

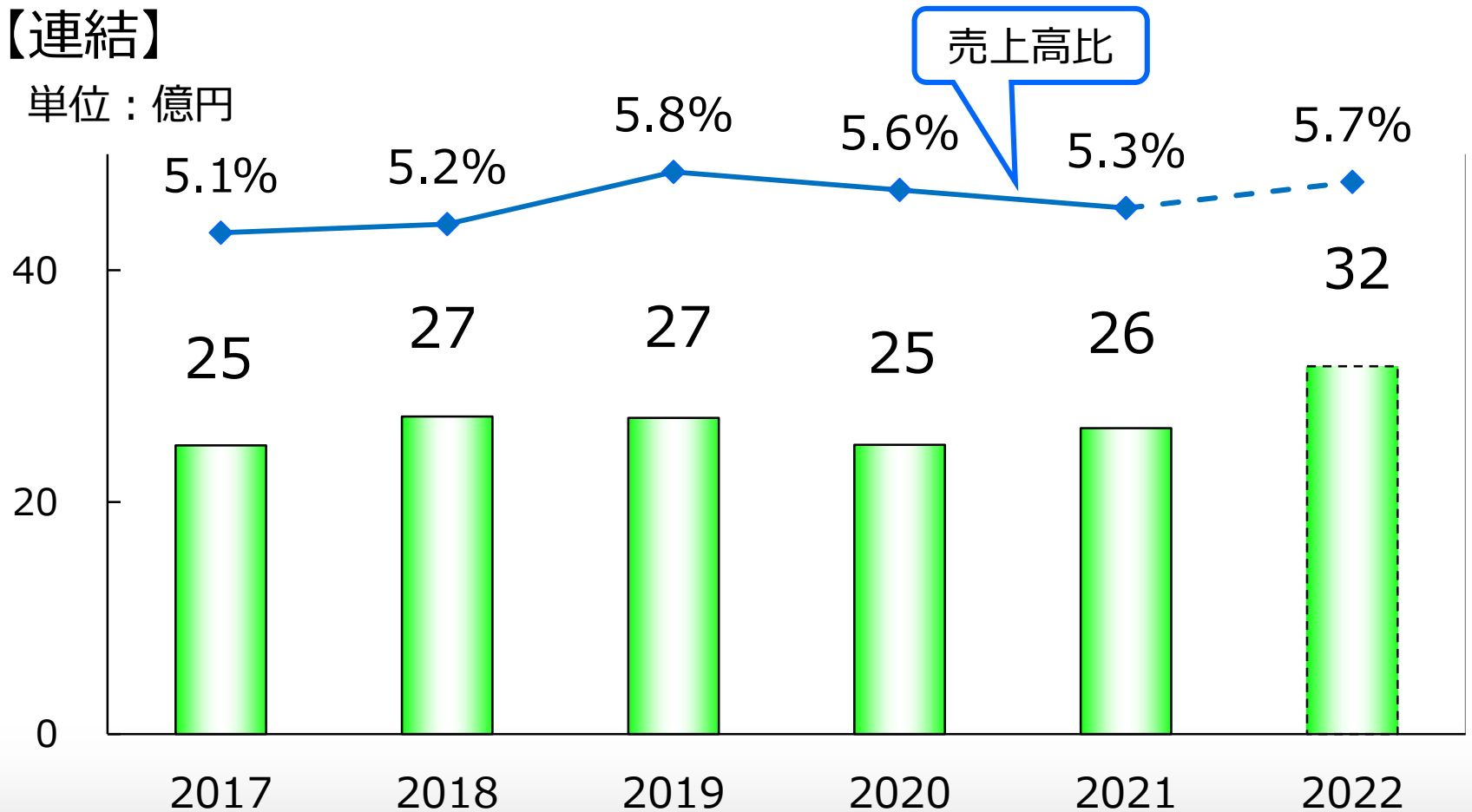
\* インクジェット錠剤印刷装置：  
ファインメカトロニクス部門FPD前工程分野に含む

## 研究開発費

## SPE分野の開発加速

【連結】

単位：億円



## 他社との連携 ①

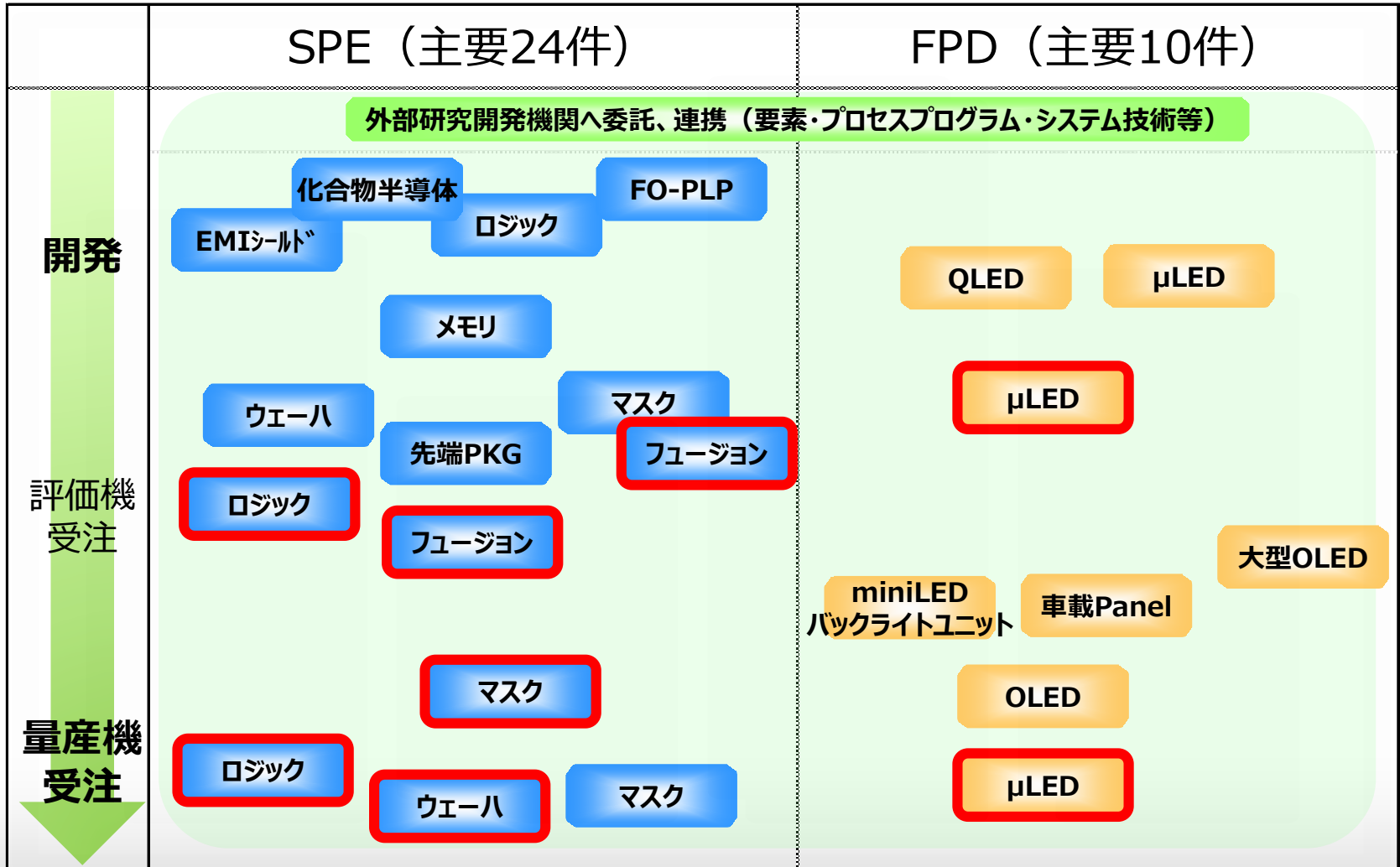
\* imec : Interuniversity Microelectronics Centre

- 装置メーカー、材料メーカー、デバイスメーカー、研究所や大学等と連携し、強い製品をよりスピーディに開発  
新たに国際研究機関 imec との半導体プロセスプログラムに参画
- 主な株主（株式会社 東芝、信越エンジニアリング株式会社、株式会社 ニューフレアテクノロジー）と連携
- 主要なテーマ計34件（前回31件）進行中  
特に、ウェーハ、マスク、ロジック、フュージョン、 $\mu$ LEDが  
順調に進捗し、事業の拡大に寄与  
新たにSPEを中心に3テーマ追加

## 他社との連携 ②

連携効果による'21年度受注実績は約30%強

\* 同じテーマ且つ進捗が同程度の複数案件は纏めて表示

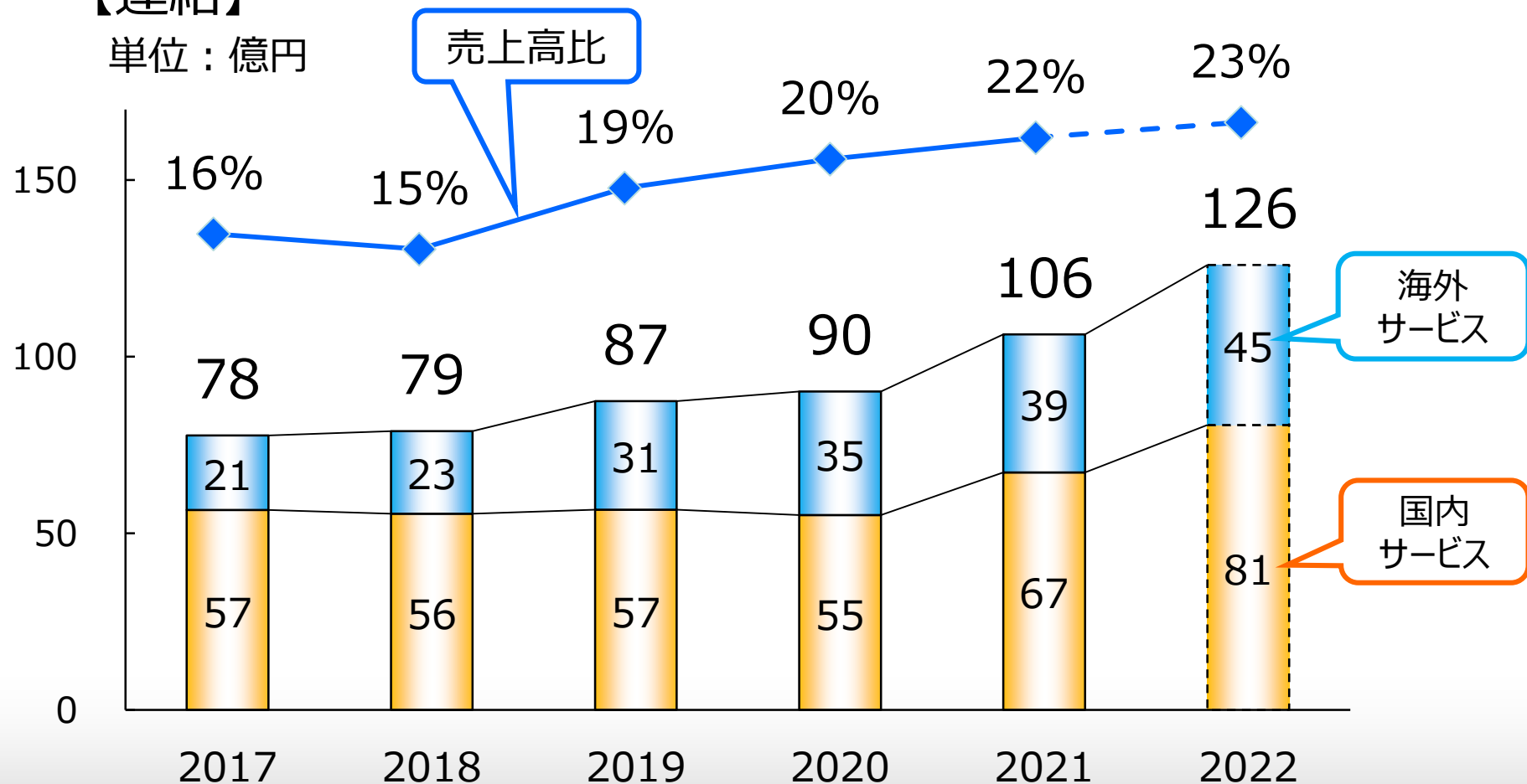


## サービス事業売上高

中計目標どおり進捗

【連結】

単位：億円



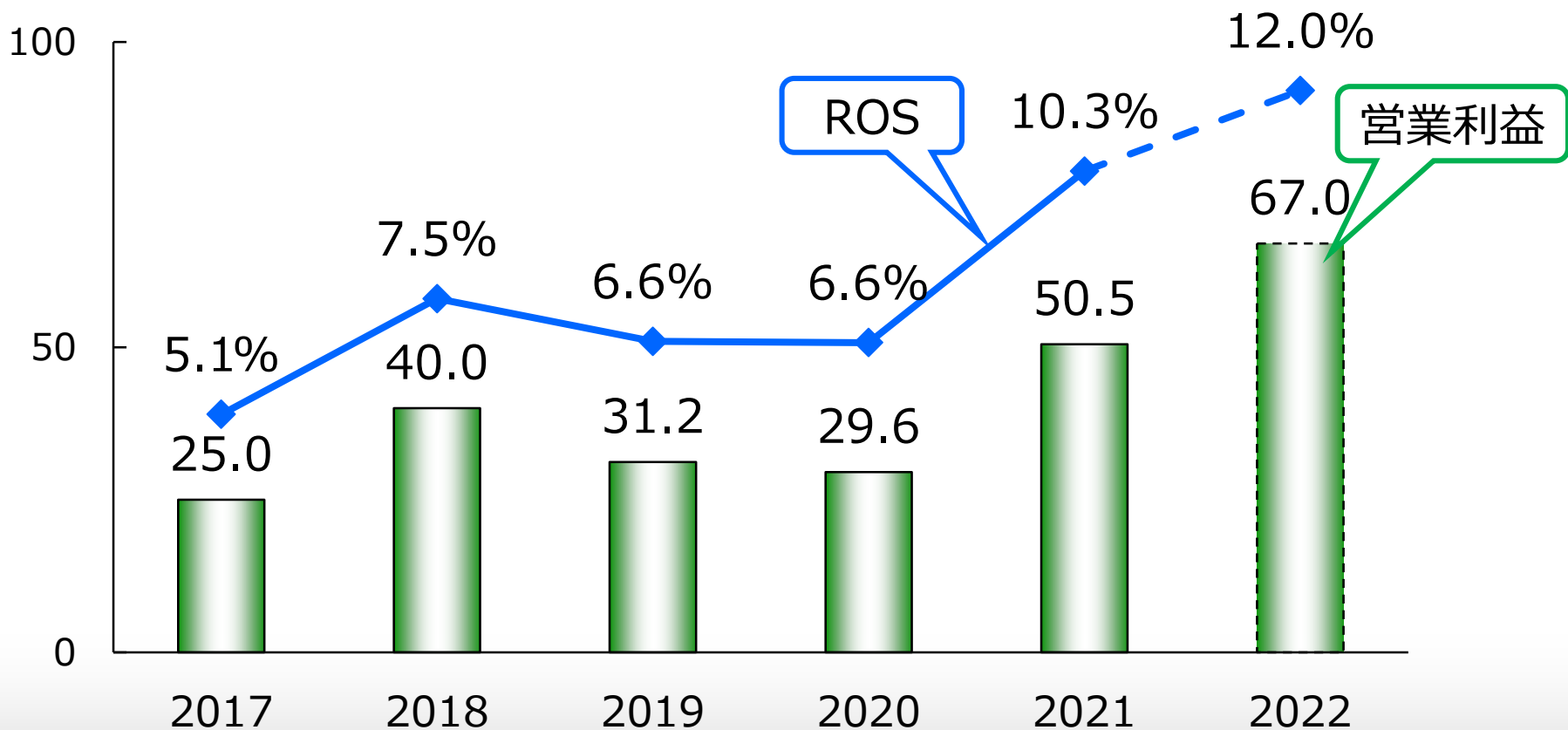


## ROS改善

【連結】

SPE分野など高付加価値製品を拡大  
 中計目標 ROS '22年度10% → 12%まで改善

単位：億円



## 製品

環境調和型製品の割合  
**'21実績：対売上高93%**  
 (目標85%以上)

## 事業プロセス

事業所エネルギー使用量\*1  
**'21実績：対前年度15.1%削減**  
 (目標1%削減)<sup>\*2</sup>

ゼロエミッション比率\*3  
**'21実績：0.04%**  
 (目標0.5%以下)

持続可能な社会ならびに  
 人々の豊かな暮らしの  
 実現に貢献できるよう  
 ESGを重視した経営を  
 行ってまいります



\*1: 原単位当たり  
 \*2: 横浜事業所再開発に伴う建屋解体の影響を含む  
 \*3: 埋立物量／総廃棄物量

# Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で  
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

END

# Appendix

## 業績

【連結】

単位：億円

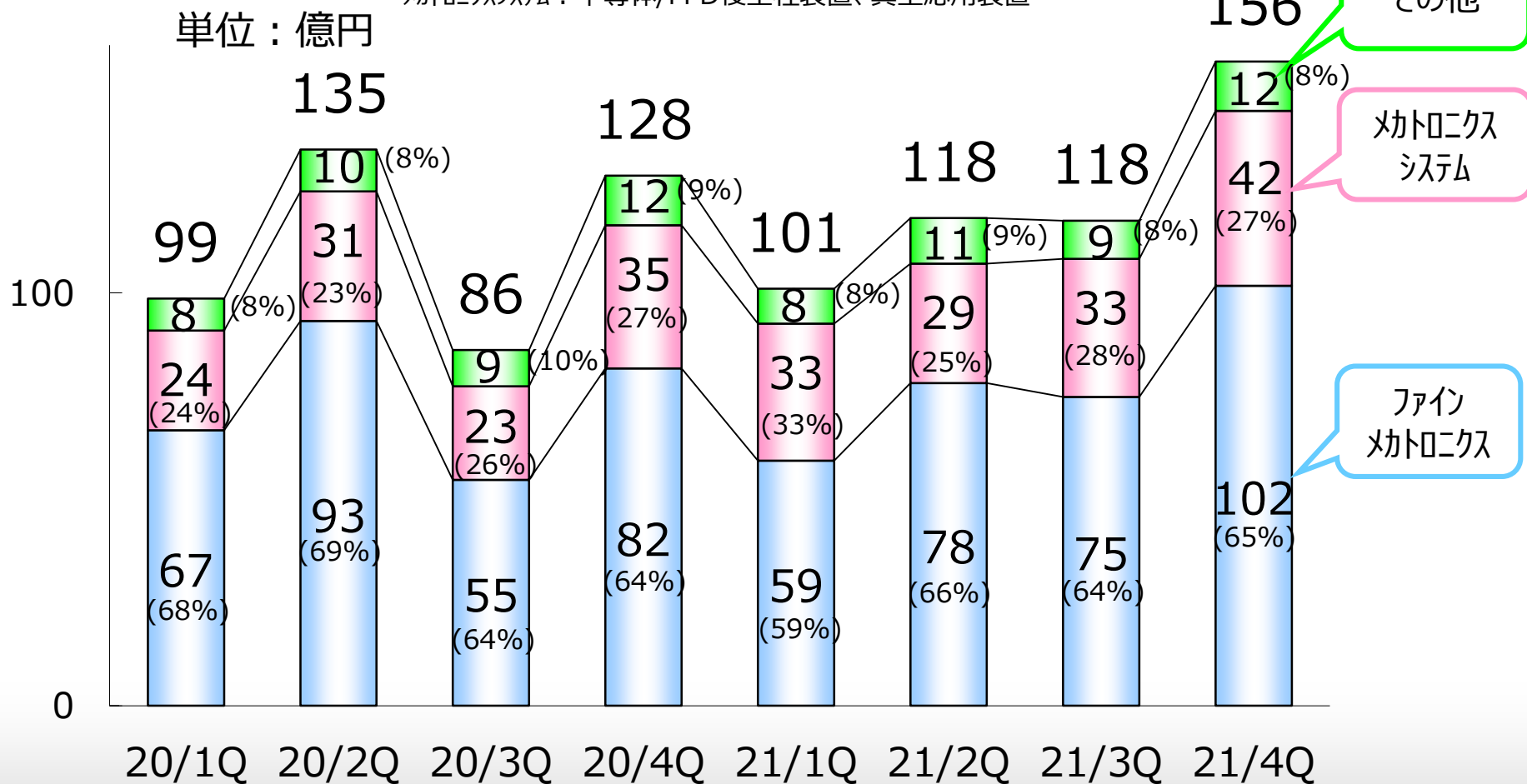
	2020					2021				
	1Q	2Q	3Q	4Q	年度	1Q	2Q	3Q	4Q	年度
売上高	99	135	86	128	448	101	118	118	156	493
営業利益	3.1	13.3	1.9	11.3	29.6	6.6	11.9	11.3	20.8	50.5
R O S	3.2%	9.9%	2.2%	8.8%	6.6%	6.5%	10.1%	9.6%	13.3%	10.3%
経常利益	3.1	12.7	1.3	11.0	28.2	6.1	11.4	10.8	20.5	48.8
特別損失	-	-	-	-	-	6.1	-	-	-	6.1
当期純利益	0.7	10.7	0.2	8.0	19.7	▲1.9	9.4	7.7	14.6	29.8
受注高	88	94	125	113	420	149	145	242	173	709

## セグメント別売上高

【連結】

\* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置

メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置



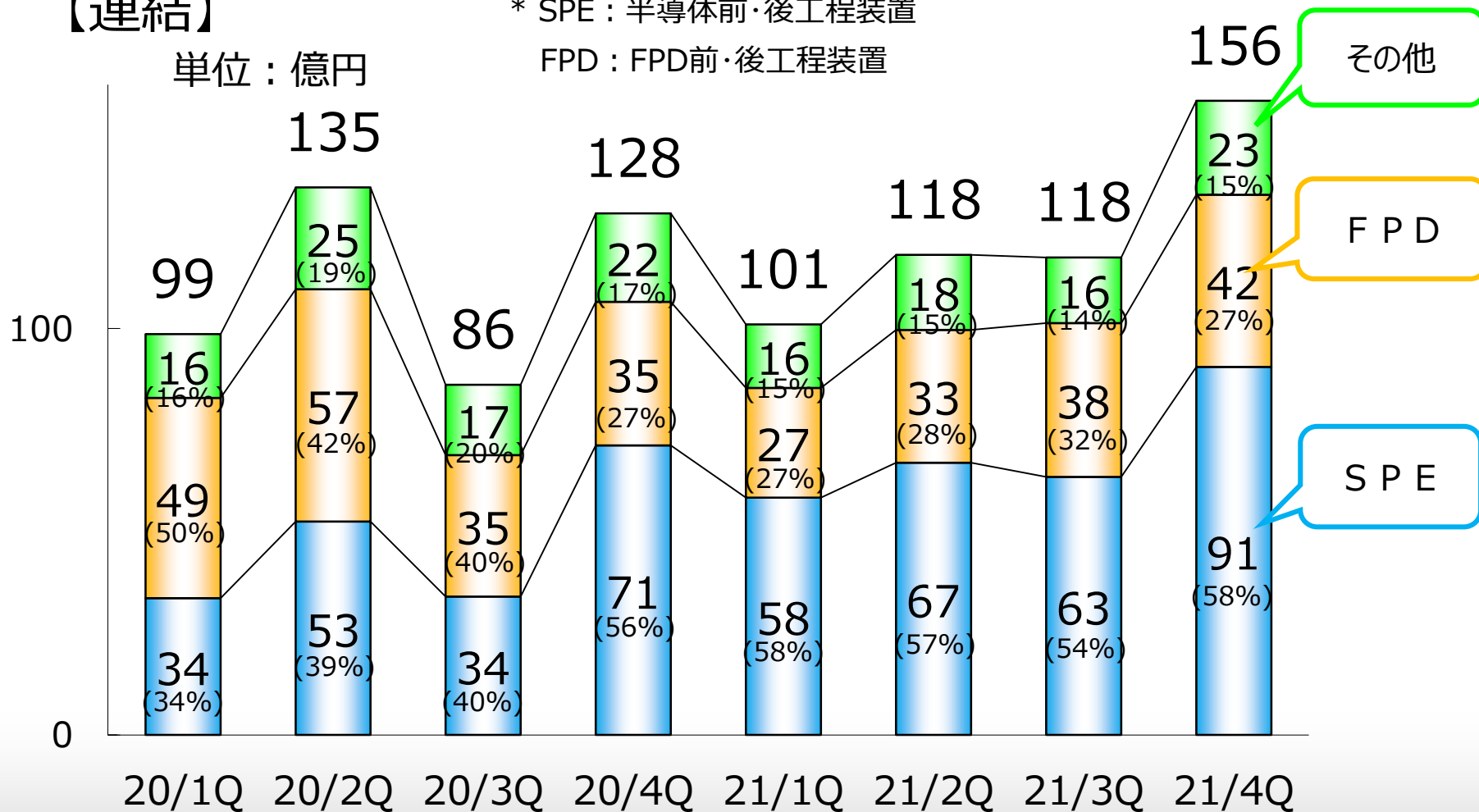
## 分野別売上高

【連結】

単位：億円

\* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置





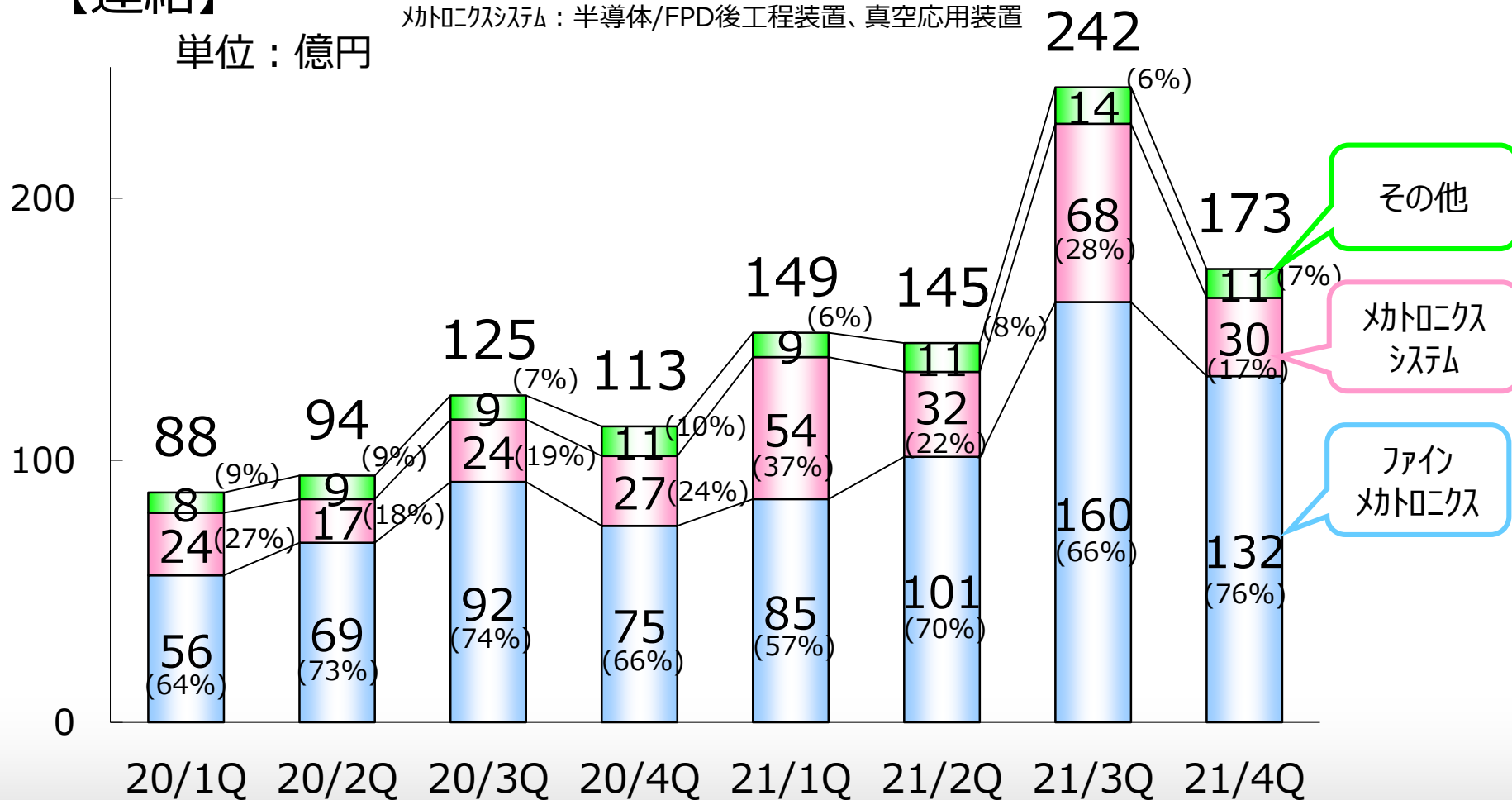
## セグメント別受注高

【連結】

\* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

単位：億円



## 分野別受注高

【連結】

単位：億円

\* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

